



鈦貿科技股份有限公司

TAI MAO TECHNOLOGY CO.,LTD.

可焊接、散熱的高強度鋼板

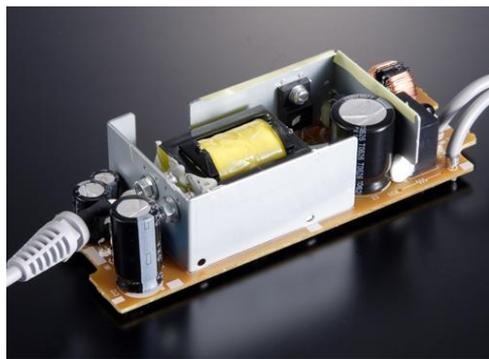
TM32 / TM32BL

METAL SERVICES

WWW.TAIMAO.COM.TW

TM32/TM32BL

- ▶ 作為無鉛的焊接用鋼板。
- ▶ 擁有能對應無鉛焊接、非活性焊劑的良好焊接性且無錫鬚生成問題。
- ▶ 具有電子零件所需要的高屏蔽特性。
- ▶ **TM32-BL**表面有黑色有機膜層，具有散熱效果。



- 能焊接在此鋼板表面。
- 相較於馬口鐵，TM32B及TM32BL更不易發生氧化。
- 不含錫，故無錫鬚生成問題。
- 表面的接觸阻抗值低，故亦可使用於接地。
- 具有防EMI特性。

TM32/TM32BL

材料結構說明

■ 純鍍鋅層

分類	錫層表面	黑色可焊性表層
塗層規格	TM32	TM32BL
塗層構成		
機能	可焊性 導電性	導電性 可焊性 散熱性
鋅含量	3 ~ 20 g / m ²	3 ~ 20 g / m ²
板厚範圍	0.15 ~ 1.2mm ※0.11 ~ 0.14別途相談	0.15 ~ 1.2mm

TM32/TM32BL

材料機械特性比較

種類	狀態	引張強度 (N/mm ²)	延伸率 (%)	硬度		
				HR-30T	HV	
SPCC	S	≥270	≥25	≤58	≤115	
	8	290~410	—	48~62	95~130	
	4	370~490	—	56~68	115~150	
	2	440~590	—	67~74	135~185	
	1	≥550	—	≥71	≥170	
加工用	TM32 高張力鋼板	A	420~550	20~35	61~71	換算值: 125~168
		B	520~650	15~35	65~75	換算值: 140~192

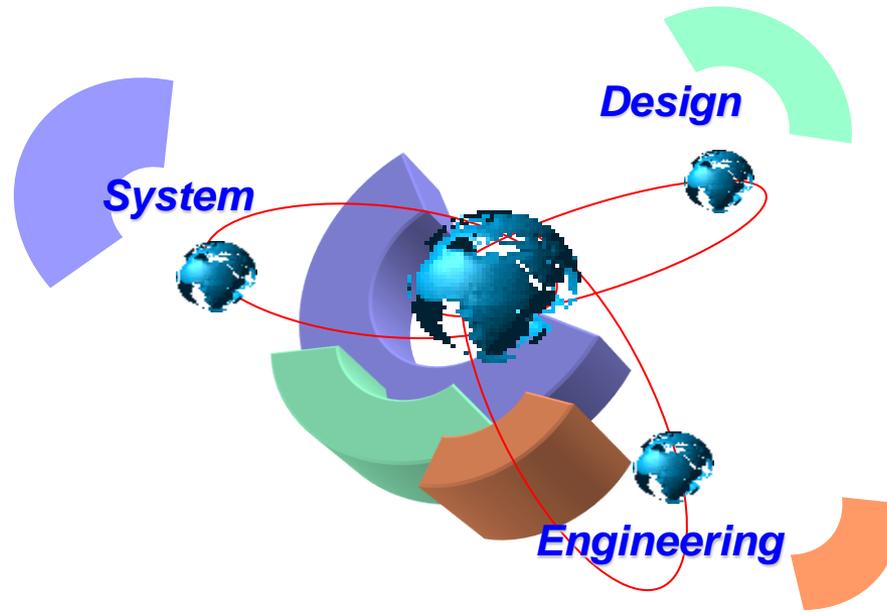
SUS304與TM3x系列 比對表

	Temper	Tensile Strength (N/mm ²)	Yield Strength (N/mm ²)	Elongation (%)	HRB	Density (g/cm ³)	Melting Point ※融点 (°C)	Modulus of Elasticity ※彈性係數 (Gpa)	Electrical resistivity ※電氣抵抗值 (Ωmm ² /m)	Thermal conductivity ※熱傳導率 (W/m·k) 100°C	Thermal expansion Coefficient ※熱膨脹係數 x10 ⁻⁶ m/°C (0-100°C)
SUS 304	2B	≥520	≥205	40	≤90	7.93	1398~1453	193-200	0.72	16.3	17.3
TM31/32/33	A	420 ~ 550	≥300	≤35	≤85	7.85	1492~1527	195-220	0.1~0.2	57~61	11.28~11.60
TM31/32/33	B	520 ~ 650	≥350	≤35	≤90	7.85	1492~1527	195-220	0.1~0.2	57~61	11.28~11.60
TM31/32/33	C	780 ~ 950	≥550	≤23	≤100	7.85	1492~1527	195-220	0.1~0.2	57~61	11.28~11.60

耐蝕性測試-鹽水噴霧測試結果

JIS Z 2371

	TM31			TM32		
	①	②	③	①	②	③
24hr.						
48hr.						



~End~

Thank you !!

METAL SERVICES